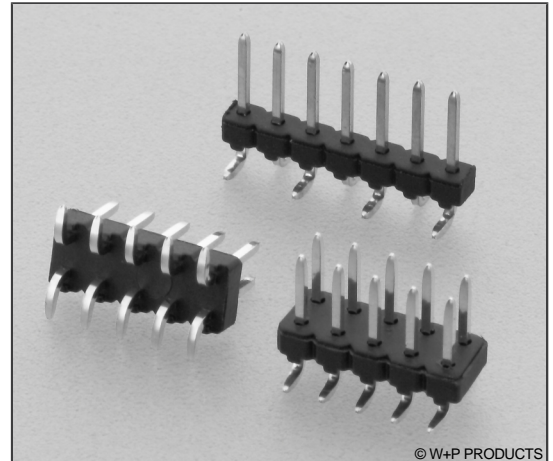


# 3532 / 3132

**SMT-Stiftleisten RM 2,54mm, stehend, 1-/2-reihig**  
**SMT Pin Headers, 2.54mm Pitch, Vertical, Single/Double Row**

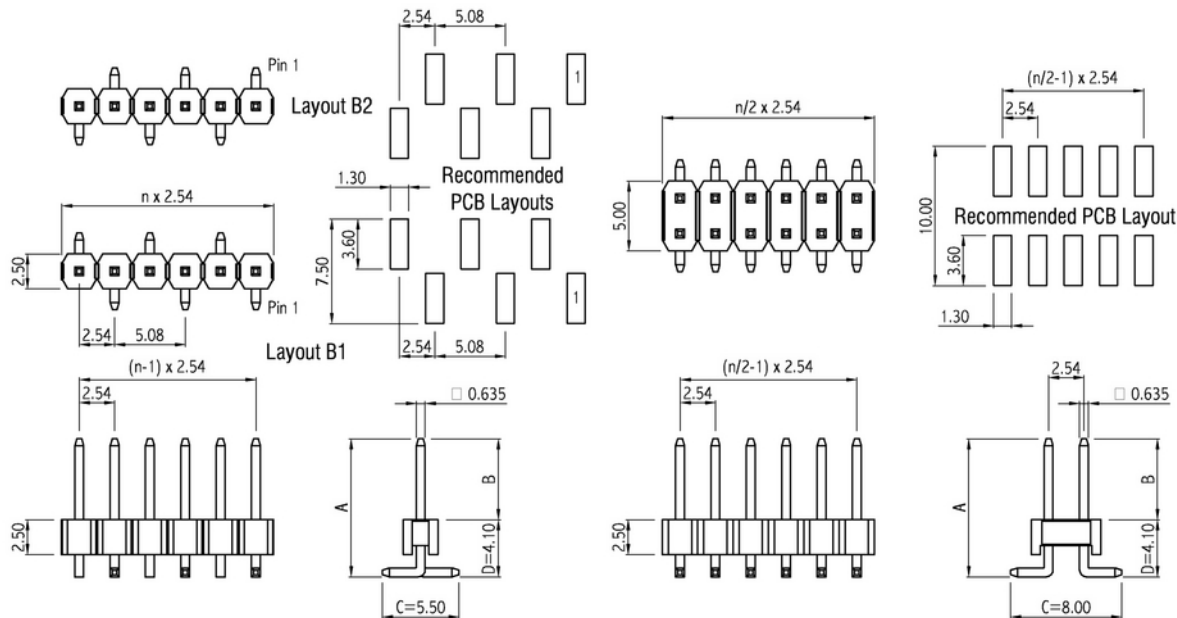
## Technische Daten / Technical Data

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Isolierkörper         | Thermoplast, nach UL94 V-0                           |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                        |
| Kontaktmaterial       | Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung               |
| Contact Material      | 0.635mm square pin, copper alloy                     |
| Kontaktoberfläche     | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)     |
| Contact Surface       | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm) |
| Durchgangswiderstand  | < 20 mΩ  |
| Contact Resistance    | < 20 mΩ  |
| Isolationswiderstand  | > 1000 MΩ  |
| Insulation Resistance | > 1000 MΩ  |
| Spannungsfestigkeit   | 1 kV DC  |
| Test Voltage          | 1 kV DC  |
| Nennspannung          | 250 V AC   |
| Voltage Rating        | 250 V AC   |
| Nennstrom             | 3 A  |
| Current Rating        | 3 A  |
| Temperaturbereich     | -55 °C ... +125 °C                                   |
| Temperature Range     | -55 °C ... +125 °C                                   |
| Verarbeitung          | Reflow-Lötverfahren                                  |
| Processing            | Reflow soldering                                     |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
 Compatible Female Headers:  
**1531 1532 3490 3491** etc.  
 Weitere siehe Kapitel B  
 Please see ch. B for more



### Series\*

**3532**

**Thermisch gerissene Kontakte**  
*Electro-strictioned contacts*  
**3532** Einreihig  
 Single row  
**3132** Zweireihig  
 Double row

### Dimensions\*

**13**

**12** A=9,40 B=5,30mm  
**13** A=10,70 B=6,60mm  
**14** A=12,00 B=7,90mm  
**15** A=12,90 B=8,80mm  
**16** A=15,80 B=11,70mm  
**17** A=17,90 B=13,80mm  
**18** A=19,70 B=15,60mm  
**19** A=20,90 B=16,80mm  
**20** A=23,00 B=18,90mm

### Contacts\*

**010**

**003-050** Einreihig  
 Single row  
**004-100** Zweireihig  
 Double row

### Plating\*

**00**

**00** Vergoldet  
 Gold plated  
**10** 0,25µm Gold  
 0.25µm gold plated  
**50** Verzinkt  
 Tin plated

### Layout\*

**1**

**0** Zweireihig (3132)  
 Double row (3132)  
**1** Layout B1 (3532)  
**2** Layout B2 (3532)

### Packaging\*

**PPTR**

**ST**  
**PPST**  
**PPTR (Option)**

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.  
 More pin length and plating options on request.

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads  
**PPTR (Option)** Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert      |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150 °C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200 °C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60 – 180s     |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217 °C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60 – 180s     |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260±5 °C      |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20 – 40s      |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s      |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m       |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values    |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150 °C        |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200 °C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60 – 180s     |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217 °C        |
| Duration above $T_L$                 | 60 – 180s     |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260±5 °C      |
| Duration Peak Temperature            | 20 – 40s      |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | max. 8min     |

